特点

- 全扩散工艺，平板型陶瓷管封装
- 中心放大门极结构
- 双面冷却

典型应用

- 大功率变流器
- 交直流电机控制
- 交直流开关、相控整流
- 有源和无源逆变

$I_{T(AV)}$	2000A
V_{DRM}/V_{RRM}	100-6500V
I_{TSM}	25 KA
I^2t	6125 10^3a^2s

符号	参数	测试条件	结温 T_J(℃)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波，50HZ 双面散热，THS=98℃	125			2000	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流	180° 正弦半波，50HZ 双面散热，THS=55℃	125			2418	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	V_{DRM}&V_{RRM} tp=10ms V_{DSM}&V_{RSM}=V_{DRM}&$V_{RRM+100V}$	125	100		6500	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	V_{DM}=V_{DRM} V_{RM}=V_{RRM}	125			200	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽，正弦半波 V_R=0.6V_{RRM}	125			25	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积					6125	A^{2S}*10
V_{TO}	门槛电压		125			0.87	V
r_T	斜率电阻					0.14	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	I_{TM}=4000A,F=15KN	25			2.4	V
dv/dt	断态电压临界上升率	V_{DM}=0.67V_{DRM}	125			1000	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	V_{DM}=67%V_{DRM} TO 1000A, 门极脉冲 tr≤0.5us I_{GM}=1.5A 重复值	125			250	A/us
I_{TM}	反向恢复电流	I_{TM}=4000A，tq=1000us Di/dt=-20A/us. V_r=50V	125			170	A
t_{rr}	反向恢复时间					20	us
Q_{rr}	恢复电荷					1700	uC
I_{GT}	门极触发电流	V_A=12V,I_A=1A	25	40		300	mA
V_{GT}	门极触发电压			0.8		3.0	V
I_H	维持电流			20		300	mA
V_{GD}	门极不触发电压	V_{DM}=0.67V_{DRM}	125	0.3			V
$R_{th(j-h)}$	热阻抗（结至散热器）	180° 正弦波，双面散热 压紧力 15KN				0.011	℃/W
F_M	安装力			35		47	KN
T_{stq}	储存温度			-40		140	℃
W_t	质量						g
Outline	外形						

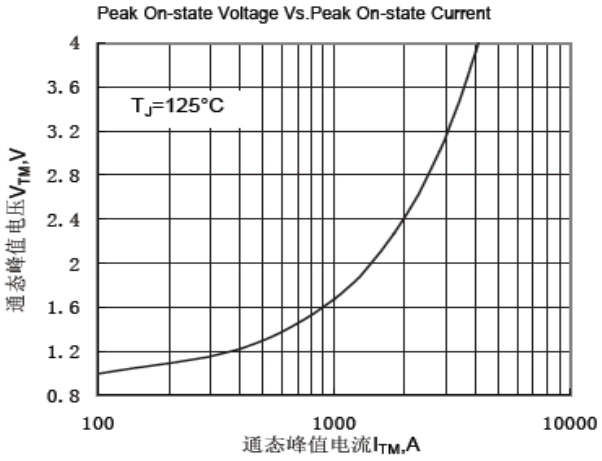

Fig.1 通态伏安特性曲线

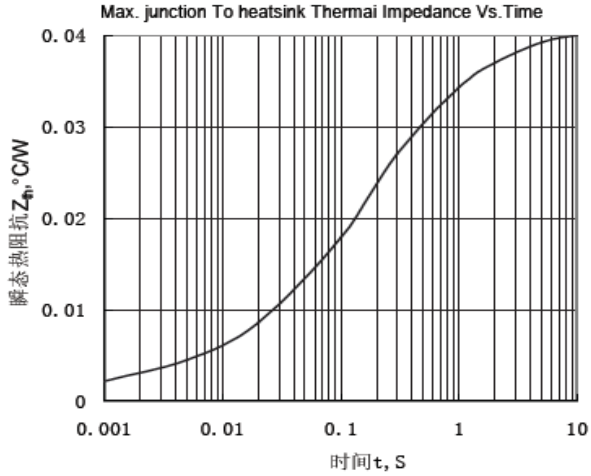

Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

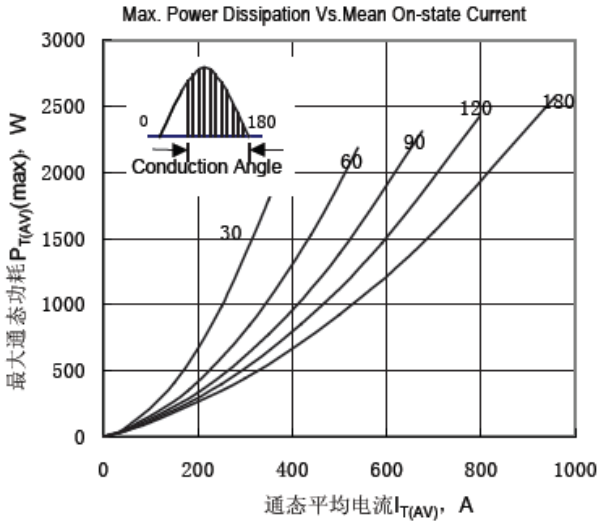

Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

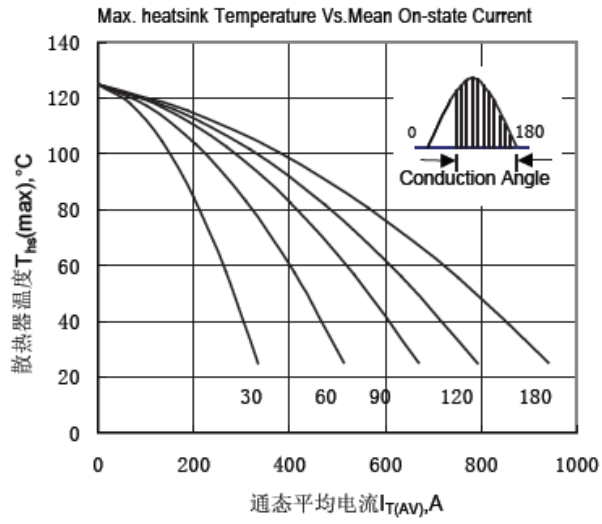

Fig.4 散热器温度与通态平均电流关系曲线

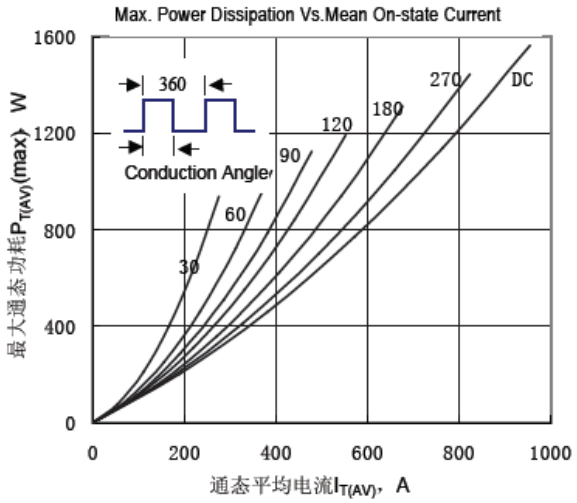

Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

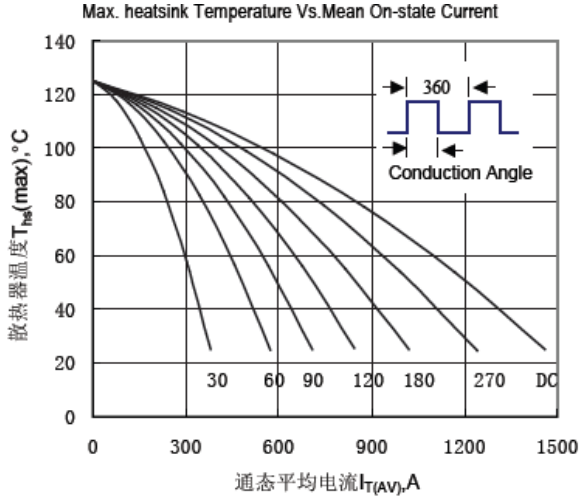

Fig.6 散热器温度与通态平均电流关系曲线

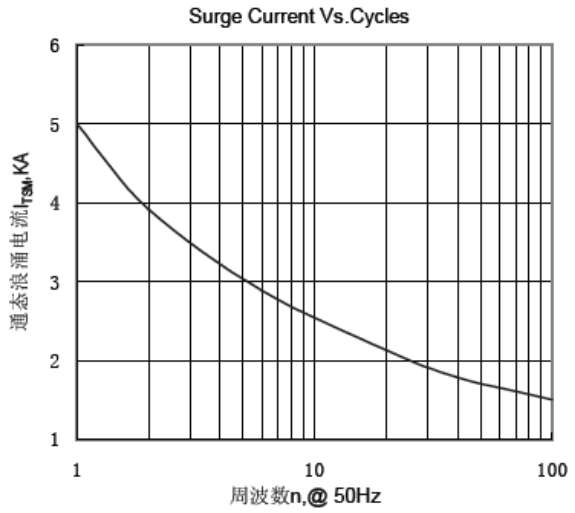

Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

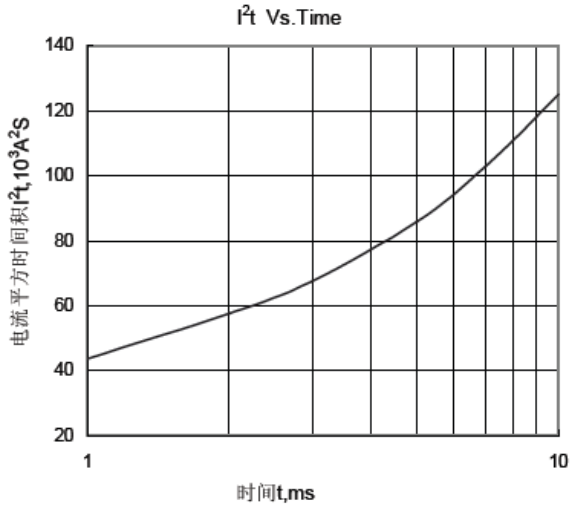

Fig.8 I^2t 特性曲线

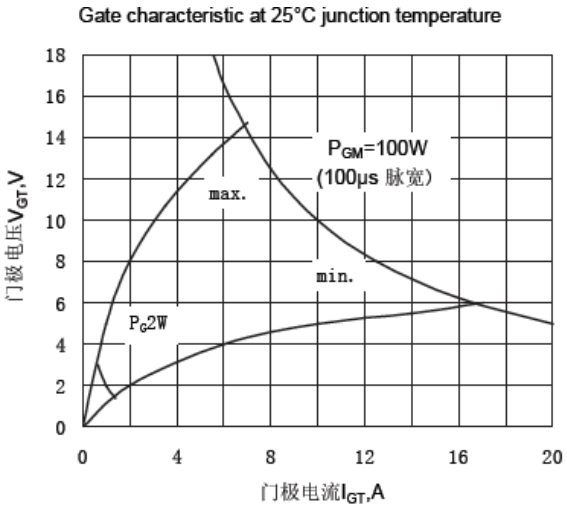

Fig.9 门极功率曲线

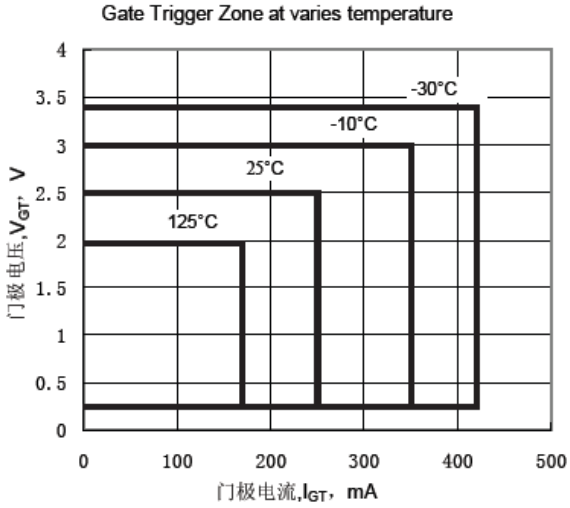

Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

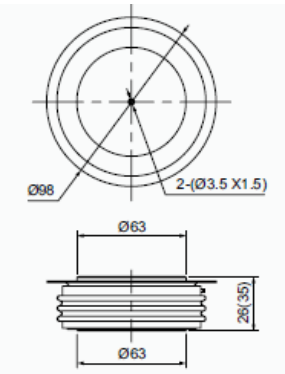

图 1

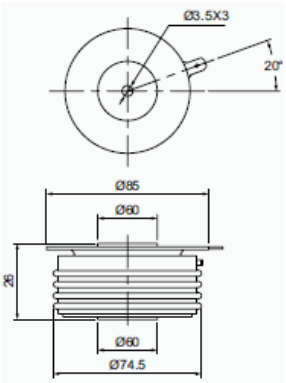

图 2

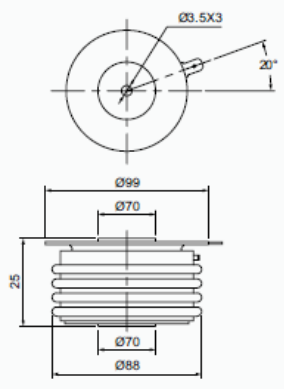

图 3

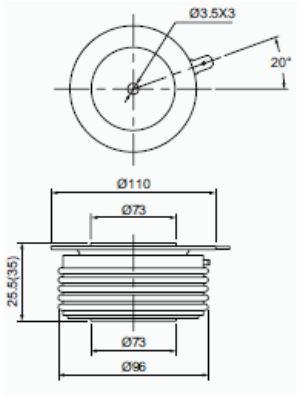

图 4